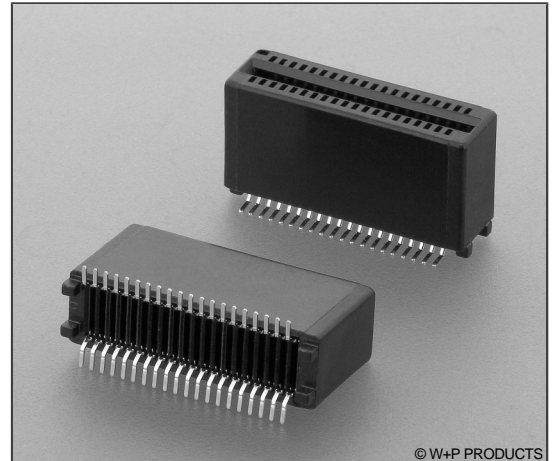


SMT Card Edge Verbinder RM 1,27mm, stehend – Single Slot Version SMT Card Edge Connectors, 1.27mm Pitch, Vertical – Single Slot Version

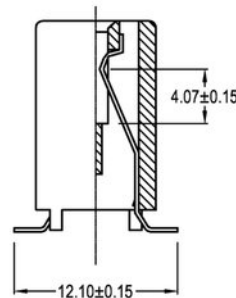
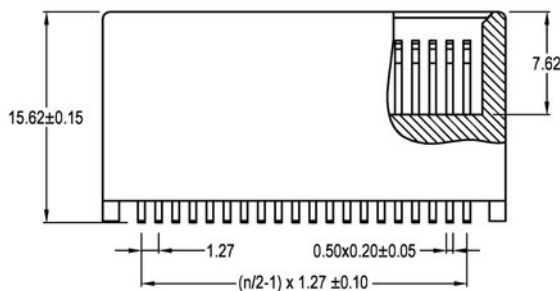
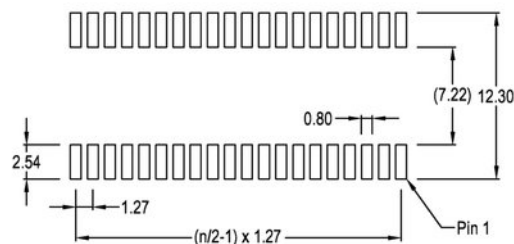
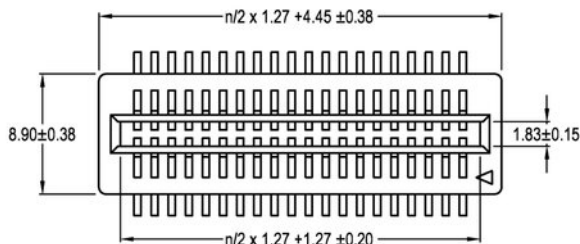
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Im Kontaktbereich vergoldet / Lötseite verzinkt (über Ni) (andere Veredelungen auf Anfrage)
Contact Surface	Au plated contact area / Sn plated solder area (over Ni) (More plating options on request)
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	125V _{AC} max.
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +105°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>
Mechanische Haltbarkeit <i>Mechanical Durability</i>	Min. 100 Steckzyklen <i>Min. 100 mating cycles</i>



© W+P PRODUCTS

Empfohlene Steckkartendicke:
1,60mm+/-0,30
Recommended PCB thickness:
1,60mm+/-0,30



Series

1211

Contacts*

060

010 020 030 040 050
060 080 100 120

Plating

60

60 Sel. Au/Sn (Standard)
Duplex plating (Standard)

Andere Veredelungen auf Anfrage.
More plating options on request.

Packaging*

PPST

00
ST
PPST
PPTR

Lieferformen / Packaging Options:

00 Schüttgut / Bulk good
ST In Stangen / In tubes
PPST In Stangen mit Pick&Place-Pads / In tubes with Pick&Place-Pads
PPTR Tape & Reel mit PP-Pads / Tape & Reel with PP-Pads

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

